

特許取得済 Patented

大電流配線と信号線を一体にすることで 省スペースを実現！

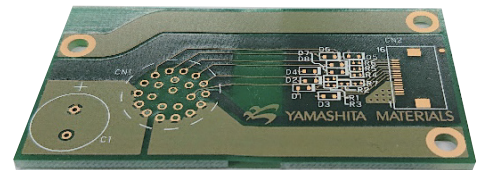
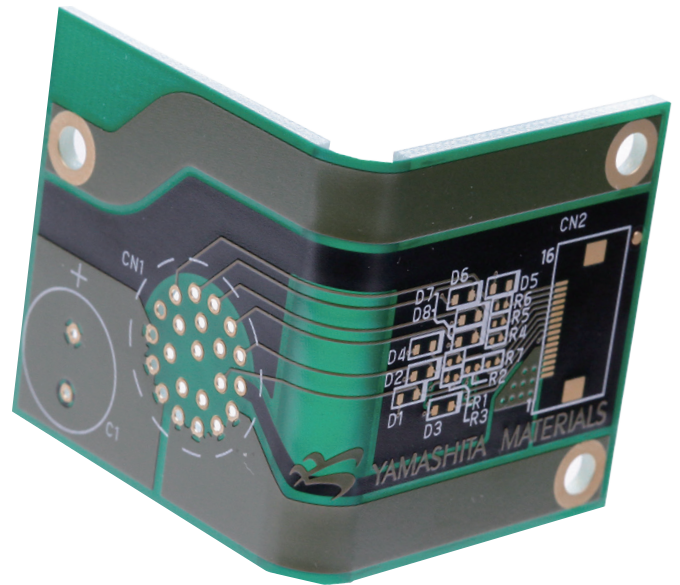
製品特徴

基材にポリイミドフィルム、
表層にソフトレジストを使用

基板を**曲げた状態**で使用することができます。
ハーネスやフラットケーブルによる基板間接続
をなくせることで、**接触抵抗軽減**や**組立工数削減**を実現。

写真製品仕様

- 構成 : FPC+GE補強板
- サイズ : 65×34mm
- 導体幅 : 5.5mm
- 導体厚み : 140 μm (合計)
- 定格 : 20A
- 最大電流 : 30A



想定用途

従来

コネクタとケーブルで接続

ご提案

全て基板を FPC で一体化

